汽车MCU芯片标准起草组成员申请表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | |
| 专家1 | | | | |
| 姓名 |  | 手机 | |  |
| 邮箱 |  | 邮编 | |  |
| 通讯地址 |  | | | |
| 专家2（选填） | | | | |
| 姓名 |  | | 手机 |  |
| 邮箱 |  | | 邮编 |  |
| 通讯地址 |  | | | |
| 单位技术能力说明 | 请详细说明单位的相关技术能力，可附页。 | | | |
| 产品应用情况介绍 | 请详细说明产品实际应用情况、量产能力、匹配车型、检测能力等内容，可附页。 | | | |
| 单位意见 | 负责人签字： | | | |

汽车车内通信芯片标准起草组成员申请表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | |
| 专家1 | | | | |
| 姓名 |  | 手机 | |  |
| 邮箱 |  | 邮编 | |  |
| 通讯地址 |  | | | |
| 专家2（选填） | | | | |
| 姓名 |  | | 手机 |  |
| 邮箱 |  | | 邮编 |  |
| 通讯地址 |  | | | |
| 单位技术能力说明 | 请详细说明单位的相关技术能力，可附页。 | | | |
| 产品应用情况介绍 | 请详细说明产品实际应用情况、量产能力、匹配车型、检测能力等内容，可附页。 | | | |
| 单位意见 | 负责人签字： | | | |

汽车存储芯片标准起草组成员申请表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | |
| 专家1 | | | | |
| 姓名 |  | 手机 | |  |
| 邮箱 |  | 邮编 | |  |
| 通讯地址 |  | | | |
| 专家2（选填） | | | | |
| 姓名 |  | | 手机 |  |
| 邮箱 |  | | 邮编 |  |
| 通讯地址 |  | | | |
| 单位技术能力说明 | 请详细说明单位的相关技术能力，可附页。 | | | |
| 产品应用情况介绍 | 请详细说明产品实际应用情况、量产能力、匹配车型、检测能力等内容，可附页。 | | | |
| 单位意见 | 负责人签字： | | | |

汽车激光雷达芯片标准起草组成员申请表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | |
| 专家1 | | | | |
| 姓名 |  | 手机 | |  |
| 邮箱 |  | 邮编 | |  |
| 通讯地址 |  | | | |
| 专家2（选填） | | | | |
| 姓名 |  | | 手机 |  |
| 邮箱 |  | | 邮编 |  |
| 通讯地址 |  | | | |
| 单位技术能力说明 | 请详细说明单位的相关技术能力，可附页。 | | | |
| 产品应用情况介绍 | 请详细说明产品实际应用情况、量产能力、匹配车型、检测能力等内容，可附页。 | | | |
| 单位意见 | 负责人签字： | | | |